

お客様各位



大型7セグメントLED製品の仕様変更について

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、下記型番の製品に関しまして品質向上を目的として内部構造の一部を変更致します。
何卒、ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品名

大型7セグメントLED、ドライバ付大型7セグメントLED

2. 対象型番

1) 大型7セグメントLED

A-38 / 45 / 76 / 100 / 127 -UR/UG

2) ドライバ付大型7セグメントLED

ML-57 / 76 / 100 / 127 -UR/UG

3. 変更理由

品質向上を目的として、LED素子をSMDタイプに置き換える事で配線が内蔵型となり、
環境変化の影響を受けにくい構造となります。

※詳細は添付別紙をご参照下さい。

4. 使用上について

LED内部構造の変更のみで、外観寸法、外部配線方法の変更はございません。

尚、仕様の詳細についてはデータシート及び各担当窓口にご確認をお願い致します。

5. 変更品との区分けについて

大型7セグメントLED単体については、

製品本体に対象型番末尾に-Sを追記致します。

6. 変更実施日

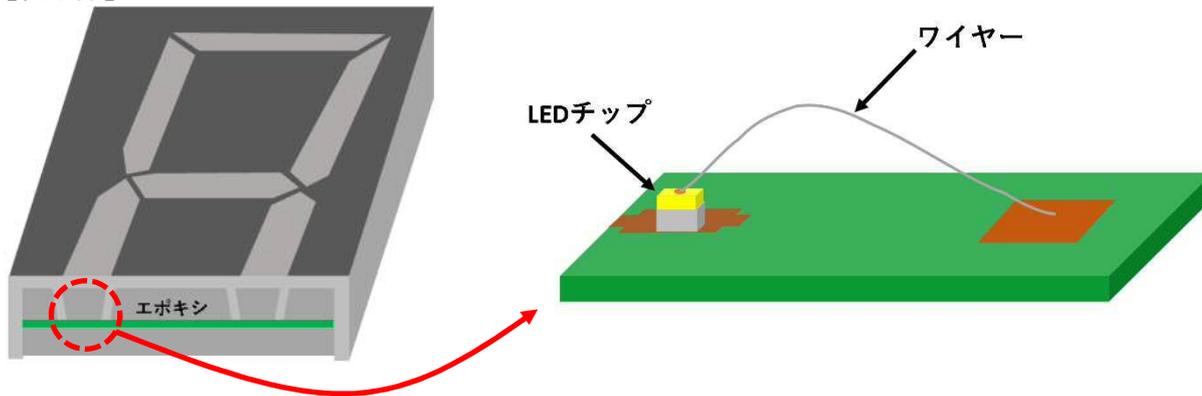
上記2、対象型番の既存在庫消化後 随時変更を実施して参ります。

以上

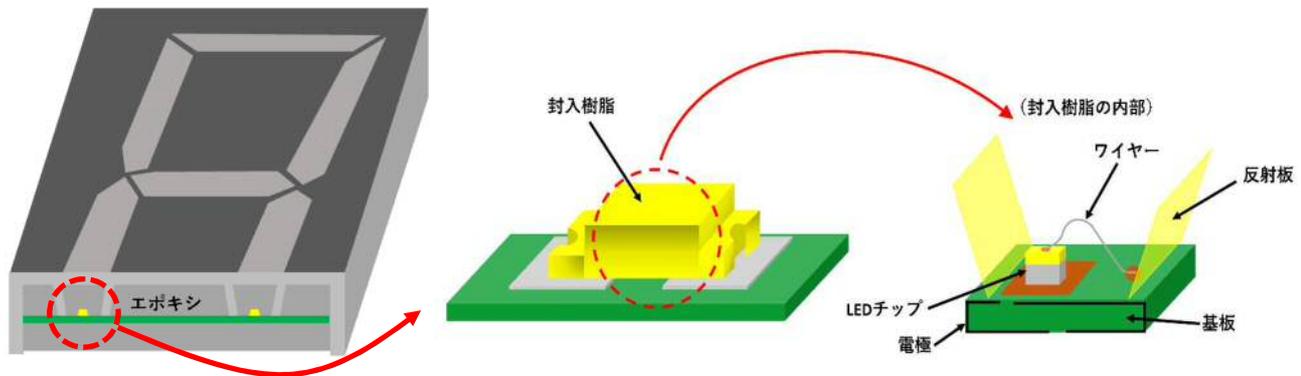
* 添付別紙

7 セグメント LED 改良部分のご説明

【従来品】



【変更後】



【解説】

従来品はボンディングワイヤに直接エポキシが充填されており、熱などによる膨張などの応力が直接 LED チップ及びボンディングワイヤに掛かる条件下にありました。

ですが、SMD パッケージに置き換えることで、チップ及びボンディングワイヤは、SMD パッケージにより保護されるため従来品より信頼性が高くなっております。